**预计全球球形硅微粉需求量将保持增长**

联瑞新材5月15日披露投资者关系活动记录表显示，随着新一代信息技术领域快速发展，新兴应用场景对半导体产品的性能、功耗等要求提升，推动半导体产品从传统封装向先进封装转变，先进封装市场需求将维持较高速的增长，封装企业的先进封装材料占比也将越来越高，由此带来的智能化升级以及导热材料市场需求旺盛。在5G通讯、消费电子和汽车电子等电子信息的迅速发展推动下，**预计全球球形硅微粉需求量将会保持较快增长**；热界面材料方面，在新能源车动力电池及光伏电池用导热胶黏剂的需求快速增长下，将快速拉动球形氧化铝粉等高导热粉体材料的需求增长。